

# 半导体硅片激光划片氮化晶圆激光切割精美打孔异形孔加工来图定制

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 半导体硅片激光划片氮化晶圆激光切割精美打孔异形孔加工来图定制             |
| 公司名称 | 北京华诺恒宇光能科技有限公司                             |
| 价格   | 50.00/件                                    |
| 规格参数 | 品牌:华诺激光<br>加工方式:激光切割加工<br>加工材质:半导体材料、硅片、晶圆 |
| 公司地址 | 北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号                  |
| 联系电话 | 13011886131                                |

## 产品详情

半导体硅片激光划片氮化晶圆激光切割精美打孔异形孔加工来图定制

晶圆激光切割方法工作效率高、能\*\*地调整待切割晶圆的各个方向的位置、精度高、全自动运行，对晶圆切割的位置进行准确定位，切割出来的晶圆芯片均匀、美观，能切割多种材料，适应性强，可以避免薄晶圆因切割破裂。